



MSP-30T

マグネトロンスパッタ

多目的簡易操作型マグネトロンスパッタ成膜装置

- 多目的、実験用成膜装置
- 電極分離型試料台で試料損傷回避
- 高速排気・簡易操作で能率的成膜
- イオンボンバードで親水性処理機能
- 小形卓上型・小スペース
- 強磁場による多種金属成膜可能
- モレキュラーシーブトラップで清浄真空
- 低価格・コストパフォーマンスの良い機能



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特 徴 ・ 仕 様

特 徴

- ★ MSP-30T は多目的、多金属、実験用イオンスパッタ成膜装置です。スパッタし易い貴金属の他、Mo,W,等の重金属から Ti,Al 等軽金属をターゲットとし、強磁場マグネトロン方式の電極により成膜が出来ます。
- ★ マグネトロン電極は、ターゲット金属表面に沿って外周から中心方向に磁場を作りターゲット全面を有効に利用できます。
- ★ スパッタ雰囲気ガス Ar は、ターゲット電極とシールド電極の間隙よりターゲット表面に噴出させ、スパッタ効率を向上させています。
- ★ 低い電圧でコーティングすると共に試料がフローティング式なので試料損傷を小さく抑えることが出来ます。
- ★ 多種金属成膜を目的に、放電中のプラズマ条件変化に対応して、一定電流になるようフィードバック制御を行い安定した成膜が出来ます。
- ★ 試料台にはシャッターを備え不安定初期スパッタ中、試料をカバーし、安定状態を確認の上、試料上への成膜を可能にしています。

仕 様

1. ターゲット : 直径 50mm ダブル磁極プレーナマグネトロン型
静電シールド採用、水冷台取付
顧客仕様による別途見積もり
2. 成膜対象金属 : ● Au ● Ag ● Pt ● Au-Pd ● Pd
● Cu ● Cr ● Pt-Pd ● Ni ● Fe
● W ● Mo ● Ta ● Ti ● Al
● ITO
3. 試料ステージ : 直径 50mm、シャッター付
4. ターゲットー試料間隔 : 50~100mm 可能、50, 75, 100mm 3種標準試料台付
5. チャンバーサイズ : 内径 150mm×深さ 150mm SUS チャンバー窓付
6. イオン化電圧 : DC 0~600V, イオン化電流 : 0~1A 電流計読み取り
7. 親水性処理 : 専用ターゲット (オプション) 使用
8. タイマー : 0~1, 2, 3, 12, 30/sec, min, hr 各自由設定. 電子タイマー
9. 排気系 : 30ℓ/sec.ターボモレキュラーポンプ、ダイヤフラムポンプ
11. 真空度測定 : フルレンジ真空計、到達真空度 : 5E-4 Pa
12. 雰囲気ガス導入 : Ar ガス、ニードルバルブ調節、電磁バルブ ON/OFF 方式
13. 安全対策 : サーキットプロテクタスイッチ、及び系統別フェーズ付
14. 装置サイズ : 本体 440W×400D×430H (mm) 重量 40 Kg
ダイヤフラムポンプ 170W×287L×173H (mm) 重量 6.5 Kg
15. 電源 : 単層 AC 100 V, 15A アース線付 3 芯プラグ使用
16. 水冷 : 1ℓ/min.

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。